SN74HCS151-Q1 带施密特触发器输入的汽车类 8 线至 1 线多路复用器

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准：
  - 器件温度等级 1：
    - 40°C 至 +125°C，T_A
  - 器件 HBM ESD 分类等级 2
  - 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 采用具有可湿性侧面的 QFN（WSOIC 或 TSSOP）封装
- 宽工作电压范围：2V 至 6V
- 施密特触发输入可耐受慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
  - I_{CC} 典型值为 100nA
  - 输入漏电流典型值为 ±100nA
- 6V 时，输出驱动为 ±7.8mA

2 应用

- 数据选择
- 多路复用

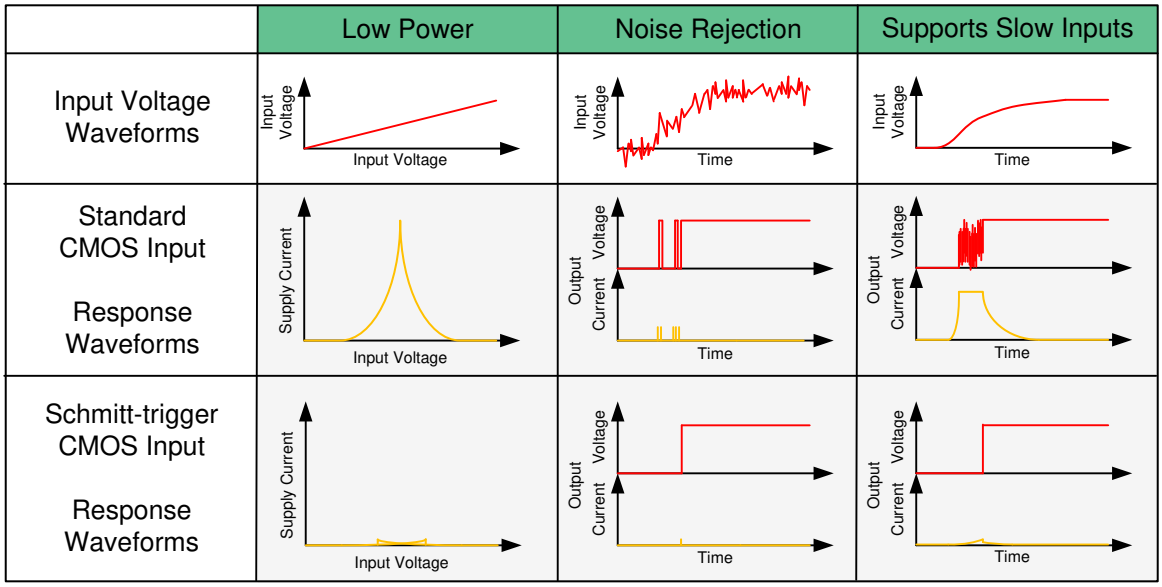
3 说明

SN74HCS151-Q1 是一款具有完整二进制解码的数据选择器/多路复用器，可从八个数据源中选择其一来提供互补输出。选通 ($\overline{G}$) 输入必须设为逻辑低电平，才能启用输入。将选通端子设为高电平，会强制 W 输出端输出高电平，Y 输出端输出低电平。

封装信息

器件型号	封装(1)	封装尺寸(2)
SN74HCS151PW-Q1	TSSOP (16)	5.00mm × 4.40mm
SN74HCS151D-Q1	SOIC (16)	9.90mm × 3.90mm
SN74HCS151WBQB-Q1	WQFN (16)	3.60mm × 2.60mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。



施密特触发输入的优势

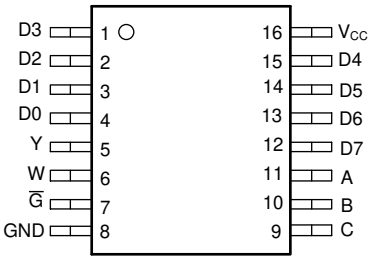
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见，TI 提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性，请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

内容

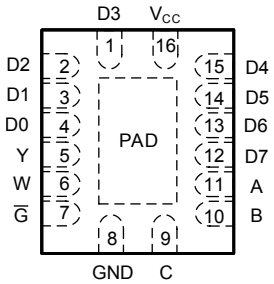
1 特性.... 1
2 应用.... 1
3 说明.... 1
4 引脚配置和功能.... 3
5 规格.... 4
5.1 绝对最大额定值.... 4
5.2 ESD 等级.... 4
5.3 建议运行条件.... 4
5.4 热性能信息.... 4
5.5 电气特性.... 5
5.6 开关特性.... 5
5.7 工作特性.... 5
5.8 典型特性.... 6
6 参数测量信息.... 7
7 详细说明.... 8
7.1 概述.... 8
7.2 功能方框图.... 8
7.3 特性说明.... 8
7.4 器件功能模式.... 12
8 应用和实施.... 13
8.1 应用信息.... 13
8.2 典型应用.... 13
8.3 电源相关建议.... 16
8.4 布局.... 16
9 器件和文档支持.... 17
9.1 文档支持.... 17
9.2 接收文档更新通知.... 17
9.3 支持资源.... 17
9.4 商标.... 17
9.5 静电放电警告.... 17
9.6 术语表.... 17
10 修订历史记录.... 17
11 机械、封装和可订购信息.... 19

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

4 引脚配置和功能



D 或 PW 封装
16 引脚 SOIC 或 TSSOP
顶视图



WBQB 封装
16 引脚 WQFN
俯视图

引脚功能

引脚		类型[2]	说明
名称	SOIC 或 TSSOP 或 WBQB 编号		
A	11	I	地址选择 A
B	10	I	地址选择 B
C	9	I	地址选择 C
D0	4	I	数据输入 0
D1	3	I	数据输入 1
D2	2	I	数据输入 2
D3	1	I	数据输入 3
D4	15	I	数据输入 4
D5	14	I	数据输入 5
D6	13	I	数据输入 6
D7	12	I	数据输入 7
$\overline{G}$	7	I	输出选通，低电平有效
GND	8	不适用	接地
散热焊盘 [1]		不适用	散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。
V_{CC}	16	不适用	正电源
W	6	O	数据输出，反相
Y	5	O	数据输出

(1) 仅限 WBQB 封装。
(2) I = 输入，O = 输出，N/A = 不适用

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）[(1)]

			最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压		-0.5	7	V
I_{IK}	输入钳位电流[(2)]	V_I < –0.5V 或 V_I > V_{CC} + 0.5V		±20	mA
I_{OK}	输出钳位电流[(2)]	V_I < –0.5V 或 V_I > V_{CC} + 0.5V		±20	mA
I_O	持续输出电流	V_O = 0 至 V_{CC}		±35	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的持续电流			±70	mA
T_J	结温[(3)]			150	°C
T_{stg}	贮存温度		-65	150	°C

(1) 超出*绝对最大额定值*范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在*建议运行条件*以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在*建议运行条件*之外但在*绝对最大额定值*范围内短暂运行，器件可能不会受到损坏，但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。
(2) 如果遵守输入和输出电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。
(3) 根据设计指定。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 AEC Q100-002[(1)]HBM ESD 分类等级 2	±4000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 AEC Q100-011 CDM ESD 分类等级 C6	±1500	

(1) AEC Q100-002 指示 HBM 应力测试应当符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	2	5	6	V
V_I	输入电压	0		V_{CC}	V
V_O	输出电压	0		V_{CC}	V
T_A	环境温度	-40		125	°C

5.4 热性能信息

热指标[(1)]		SN74HCS151-Q1			单位
		PW (TSSOP)	D (SOIC)	WBQB (WQFN)	
		16 引脚	16 引脚	16 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	141.2	122.2	97.3	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	78.8	80.9	93.8	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	85.8	80.6	66.4	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	27.7	40.4	14.6	°C/W
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	85.5	80.3	66.4	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	不适用	不适用	44.3	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅*半导体和 IC 封装热指标*应用手册。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.5 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内；典型值在 T_A = 25°C 时测得（除非另有说明）。

参数		测试条件		V_{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
V_{T+}	正开关阈值			2V	1.13	1.24	1.35	V
				4.5V	2.3	2.54	2.7	
				6V	3	3.26	3.49	
V_{T-}	负开关阈值			2V	0.65	0.76	0.84	V
				4.5V	1.48	1.71	1.87	
				6V	1.95	2.24	2.45	
ΔV_T	迟滞 (V_{T+} - V_{T-})(1)			2V	0.29	0.48	0.62	V
				4.5V	0.52	0.82	1.03	
				6V	0.67	1.02	1.29	
V_{OH}	高电平输出电压	V_I = V_{IH} 或 V_{IL}	I_{OH} = -20μA	2V 至 6V	V_{CC} – 0.1	V_{CC} – 0.002		V
			I_{OH} = -6mA	4.5V	4.0	4.3		
			I_{OH} = -7.8mA	6V	5.4	5.75		
V_{OL}	低电平输出电压	V_I = V_{IH} 或 V_{IL}	I_{OL} = 20μA	2V 至 6V		0.002	0.1	V
			I_{OL} = 6mA	4.5V		0.18	0.30	
			I_{OL} = 7.8mA	6V		0.22	0.33	
I_I	输入漏电流	V_I = V_{CC} 或 0		6V		±100	±1000	nA
I_{CC}	电源电流	V_I = V_{CC} 或 0，I_O = 0		6V		0.1	2	μA
C_i	输入电容			2V 至 6V			5	pF

(1) 根据设计指定。

5.6 开关特性

C_L = 50pF；在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）。请参阅*参数测量信息*。

参数		自	至	V_{CC}	自然通风工作温度范围 (T_A)						单位
					25°C			-40°C 至 125°C			
					最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
t_{pd}	传播延迟	A、B 或 C	Y 或 W	2V		21	32			55	ns
				4.5V		8	12			20	
				6V		7	11			17	
		任何 D	Y 或 W	2V		22	33			53	
				4.5V		9	14			20	
				6V		7	11			17	
		$\overline{G}$	Y 或 W	2V		19	29			48	
				4.5V		8	12			17	
				6V		7	11			14	
t_t	转换时间		任意输出	2V			9			16	ns
				4.5V			5			9	
				6V			4			8	

5.7 工作特性

在自然通风条件下的工作温度范围内；典型值在 T_A = 25°C 时测得（除非另有说明）。

参数		测试条件	V_{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
C_{pd}	每个栅极的功率耗散电容	无负载	2V 至 6V		25		pF

5.8 典型特性

T_A = 25°C

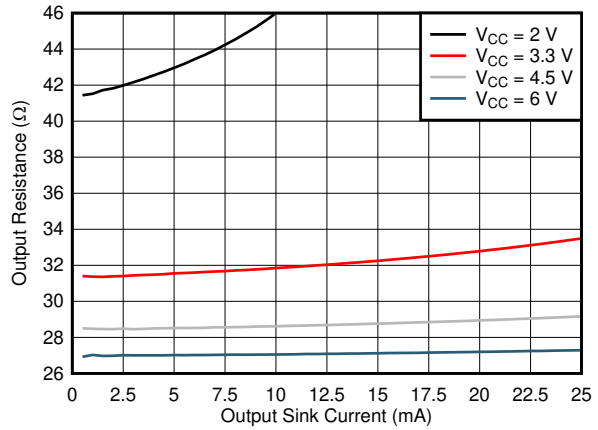


图 5-1. 低电平状态下的输出驱动器电阻

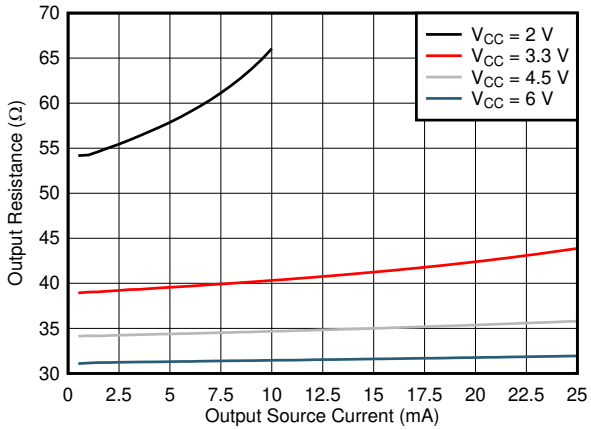


图 5-2. 高电平状态下的输出驱动器电阻

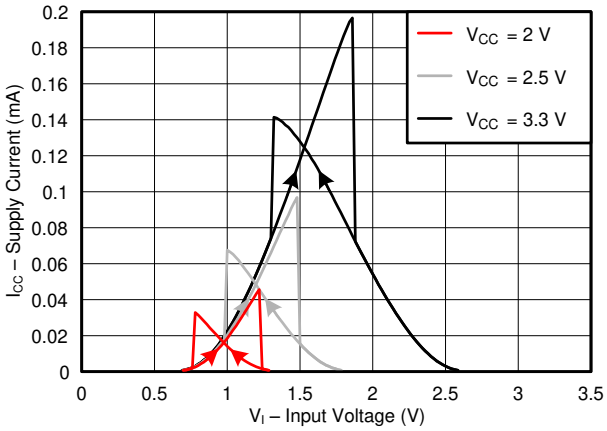


图 5-3. 2V、2.5V 和 3.3V 输入电压电源上的电源电流

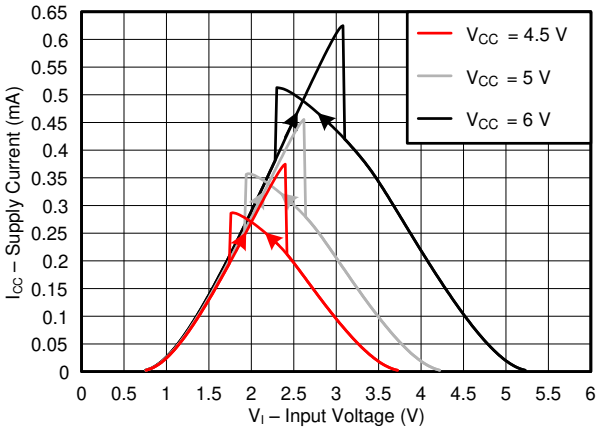


图 5-4. 4.5V、5V 和 6V 输入电压电源上的电源电流

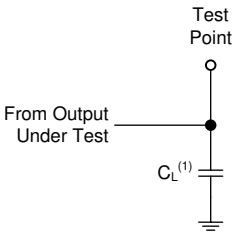
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

6 参数测量信息

任意选择波形之间的相位关系。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：PRR ≤ 1MHz，Z_O = 50Ω，t_t < 2.5ns。

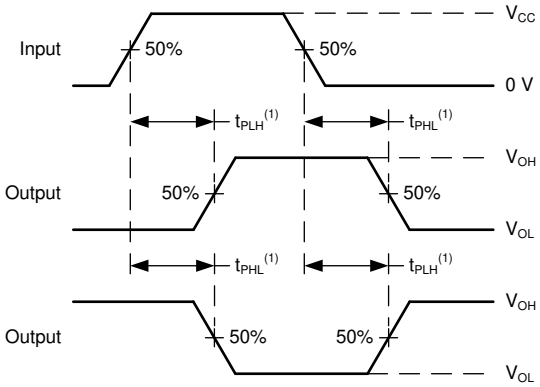
对于时钟输入，f_{max} 是在输入占空比为 50% 时测量的。

一次测量一个输出，每次测量一个输入转换。



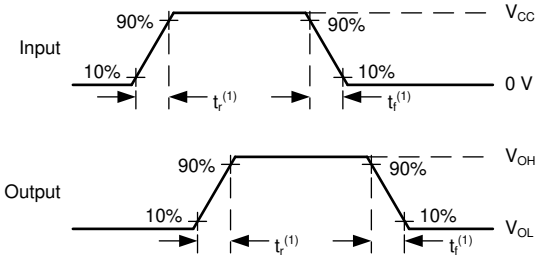
(1) C_L 包括探头和测试夹具电容。

图 6-1. 推挽输出的负载电路



(1) t_{PLH} 和 t_{PHL} 之间的较大者与 t_{pd} 相同。

图 6-2. 电压波形传播延迟



(1) t_r 和 t_f 之间的较大值与 t_t 相同。

图 6-3. 电压波形，输入和输出转换时间

7 详细说明

7.1 概述

SN74HCS151-Q1 是一款高速硅栅 CMOS 多路复用器，非常适合多路复用和数据路由应用。它包含单个 8:1 多路复用器。

SN74HCS151-Q1 异步运行，Y 输出等于地址输入 (A、B、C) 所选的输入。W 输出始终与 Y 输出相反。

无论其他输入的状态如何，选通 ($\overline{G}$) 输入都会强制所有 Y 输出为低电平且 W 输出为高电平。

所有输入均包括施密特触发，允许慢速输入转换并提供额外的噪声容限。

7.2 功能方框图

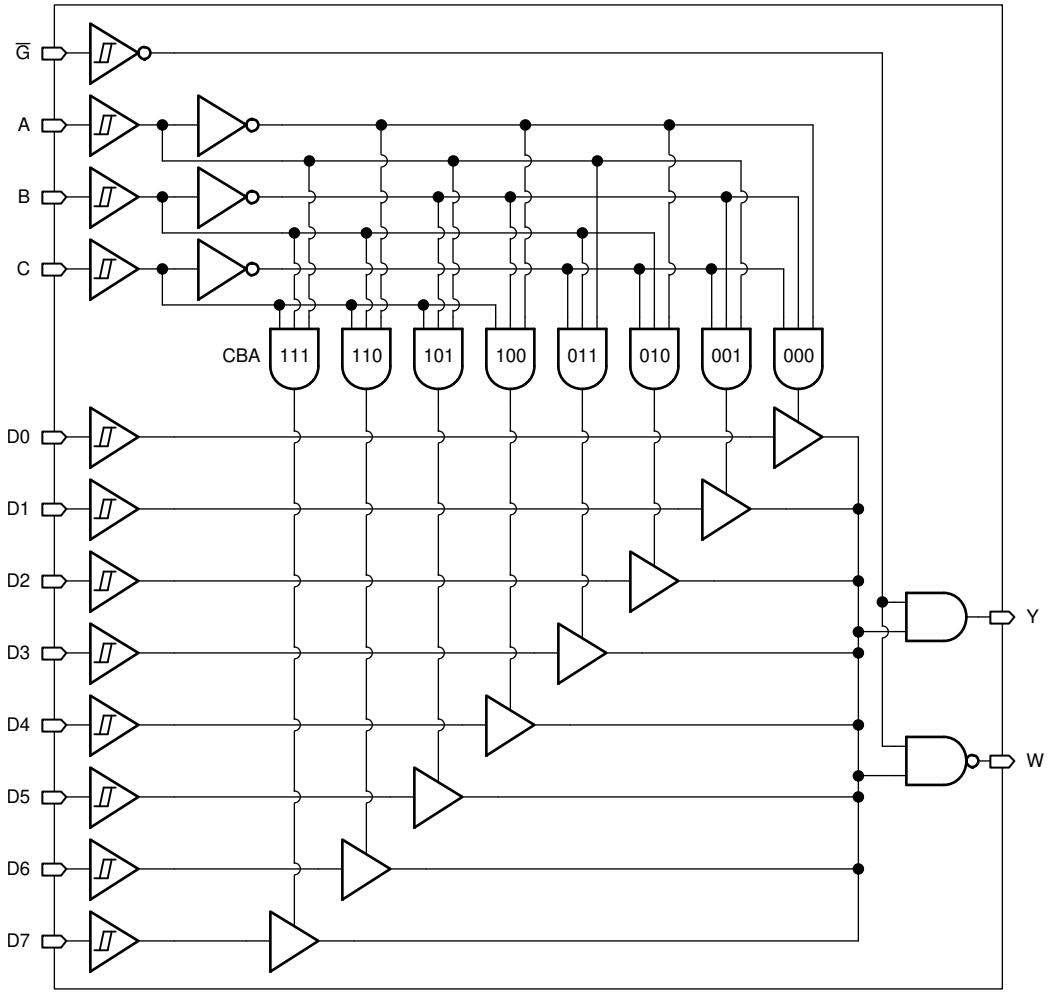


图 7-1. SN74HCS151-Q1 的逻辑图（正逻辑）

7.3 特性说明

7.3.1 平衡 CMOS 推挽式输出

该器件包括平衡 CMOS 推挽输出。术语*平衡*表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边沿，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大，而不会损坏器件。务必限制器件的输出功率，以避免因过流而损坏器件。必须始终遵守*绝对最大额定值*中规定的电气和热限值。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

未使用的推挽 CMOS 输出必须保持断开状态。

7.3.2 CMOS 施密特触发输入

此器件包括具有施密特触发架构的输入。这些输入为高阻抗，通常建模为从输入到地之间、与输入电容（电容值在*电气特性* 表中规定）并联的电阻器。最坏情况下的电阻是使用*绝对最大额定值* 表中给出的最大输入电压和*电气特性* 表中给出的最大输入漏电流，根据欧姆定律 (R = V ÷ I) 计算得出的。

施密特触发输入架构可提供由*电气特性* 表中的 ΔV_T 定义的迟滞，因而此器件能够很好地耐受慢速或高噪声输入。虽然输入的驱动速度可能比标准 CMOS 输入慢得多，但仍建议正确端接未使用的输入。使用缓慢的转换信号驱动输入会增加器件的动态电流消耗。有关施密特触发输入的其他信息，请参阅*了解施密特触发*。

7.3.3 钳位二极管结构

该器件的输入和输出同时具有正和负钳位二极管，如图 7-2 所示。

> **小心**
>
> 电压超出*绝对最大额定值* 表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

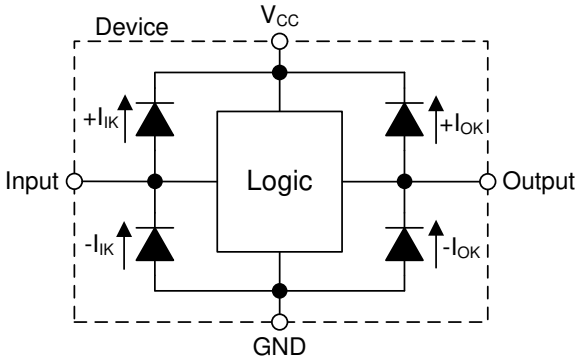


图 7-2. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.3.4 可润湿侧翼

该器件采用至少一种具有可润湿侧翼的封装。请参阅数据表首页上的*特性* 部分，了解哪些封装包含此特性。

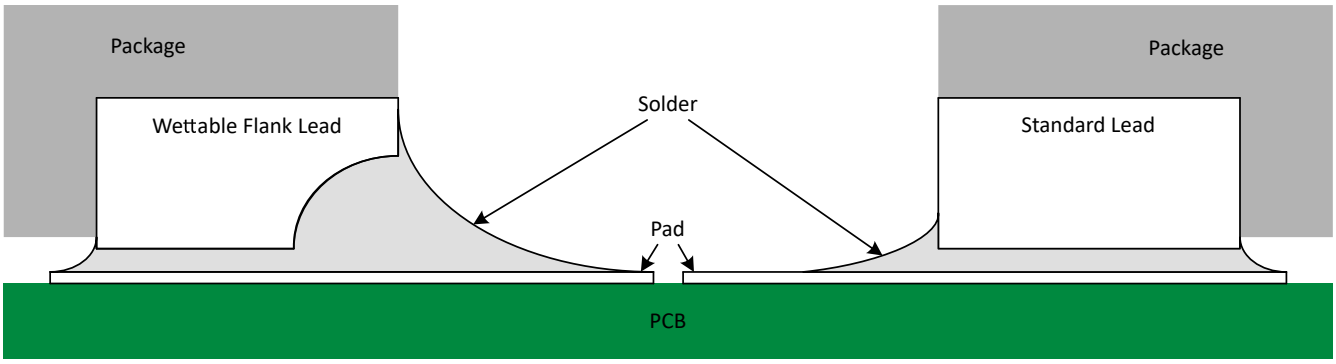


图 7-3. 焊接后具有可润湿侧翼的 QFN 封装和标准 QFN 封装的简化剖面图

可润湿侧翼有助于改善焊接后的侧翼润湿性，从而使 QFN 封装可通过自动光学检测 (AOI) 轻松检测。如图 7-3 所示，可润湿侧翼可做出凹陷或进行阶梯切割，为焊接粘附提供额外的表面积，有助于可靠创建侧面填角。有关其他详细信息，请参阅机械图。

7.4 器件功能模式

功能表 列出了 SN74HCS151-Q1 的功能模式。

表 7-1. 功能表

输入(1)				输出(2)	
选择			选通	Y	W
C	B	A	$\overline{G}$		
X	X	X	H	L	H
L	L	L	L	D0	$\overline{D0}$
L	L	H	L	D1	$\overline{D1}$
L	H	L	L	D2	$\overline{D2}$
L	H	H	L	D3	$\overline{D3}$
H	L	L	L	D4	$\overline{D4}$
H	L	H	L	D5	$\overline{D5}$
H	H	L	L	D6	$\overline{D6}$
H	H	H	L	D7	$\overline{D7}$

(1) H = 高电压电平，L = 低电压电平，X = 不用考虑
(2) H = 驱动为高电平，L = 驱动为低电平，Dx = 驱动值与 Dx 输入相同，$\overline{Dx}$ = 驱动值与 Dx 输入相反

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客 户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

SN74HCS151-Q1 是一款 8 线至 1 线数据选择器/多路复用器。本应用展示在具备所有必需连接的情况下使用器件的示例。

8.2 典型应用

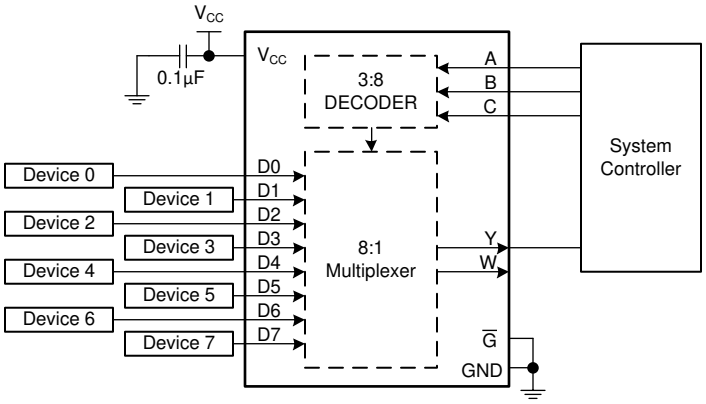


图 8-1. 典型应用框图

8.2.1 设计要求

8.2.1.1 电源注意事项

确保所需电源电压在 *电气特性* 中规定的范围内。电源电压决定器件的电气特性，如 *电气特性* 部分所述。

正电压电源必须能够提供的电流等于 SN74HCS151-Q1 所有输出端拉出的总电流加上最大静态电源电流 I_{CC}（在 *电气特性* 中列出）以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。确保不要超过*绝对最大额定值* 中列出的通过 V_{CC} 的最大总电流。

地必须能够灌入的电流等于 SN74HCS151-Q1 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 I_{CC}（在 *电气特性* 中列出）以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 GND 的最大总电流。

SN74HCS151-Q1 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载，同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载；但建议不要超过 50pF。

SN74HCS151-Q1 可以驱动由 $R_L \geqslant V_O/I_O$ 描述的总电阻负载，输出电压和电流在 *电气特性* 表中用 V_{OH} 和 V_{OL} 定义。在高电平状态下输出时，公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 V_{CC} 引脚处的电源电压之间的差值。

总功耗可以使用 *CMOS 功耗与 Cpd 计算*应用手册中提供的信息进行计算。

可以使用*标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性*应用手册中提供的信息计算热增量。

> **小心**
> *绝对最大额定值* 中列出的最高结温 $T_{J(max)}$ 是防止损坏器件的附加限制。请勿违反*绝对最大额定值* 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

8.2.1.2 输入注意事项

输入信号必须超过 $V_{t-(min)}$ 才能被视为逻辑低电平，超过 $V_{t+(max)}$ 才能被视为逻辑高电平。不要超过*绝对最大额定值* 中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至 V_{CC} 或地。如果输入完全不使用，则可以直接端接未使用的输入，如果有时要使用输入，但并非始终使用，则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态，下拉电阻用于默认低电平状态。控制器的驱动电流、进入 SN74HCS151-Q1 的漏电流（如*电气特性* 中所规定）以及所需输入转换率会限制电阻值。由于这些因素，通常使用 10kΩ 的电阻值。

SN74HCS151-Q1 由于具有施密特触发输入，因而没有输入信号转换速率要求。

具有施密特触发输入的另一个优势是能够抑制噪声。振幅足够大的噪声仍然会导致问题。要了解噪声大到什么程度才是过大，请参考电气特性中的 $\Delta V_{T(min)}$。此迟滞值将提供峰峰值限制。

与标准 CMOS 输入不同，施密特触发输入可以保持在任何有效值，而不会导致功耗大幅增加。将输入保持在 V_{CC} 或地电平以外的值所导致的典型附加电流绘制在典型特性中。

有关此器件的输入的附加信息，请参阅*特性描述*。

8.2.1.3 输出注意事项

正电源电压用于产生高电平输出电压。根据 *电气特性* 中 V_{OH} 规格所示，从输出端汲取电流将降低输出电压。接地电压用于产生低电平输出电压。根据 *电气特性* 中 V_{OL} 规格所示，向输出端灌入电流将提高输出电压。

可能处于相反状态的推挽输出始终不应直接连接在一起，即使时间很短也不例外。否则可能会导致电流过大并损坏器件。

同一器件内具有相同输入信号的两个通道可以并联，以获得额外的输出驱动强度。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 V_{CC} 或地。

有关此器件的输出的其他信息，请参阅*特性说明* 部分。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8.2.2 详细设计过程

1. 在 V_{CC} 至 GND 之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近 V_{CC} 和 GND 引脚。*布局* 部分中展示了示例布局。
2. 验证输出端的容性负载是否 ≤ 50pF。这不是硬性限制；但是，根据设计，该限制将优化性能。这可以通过从 SN74HCS151-Q1 向一个或多个接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 验证输出端的电阻负载是否大于 $(V_{CC} / I_{O(max)})\Omega$。这可防止超出 *绝对最大额定值* 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 MΩ 为单位的电阻负载；远大于之前计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注热问题；然而，可以使用应用手册 *CMOS 功耗与 Cpd 计算* 中提供的步骤计算功耗和热增量。

8.2.3 应用曲线

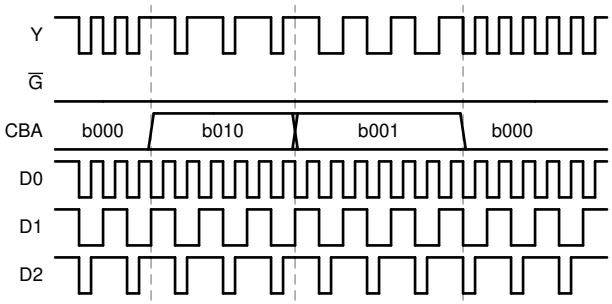


图 8-2. 应用时序图

8.3 电源相关建议

电源可以是*建议运行条件* 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 V_{CC} 端子均应具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用 0.1 μF 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1 μF 和 1 μF 电容器通常并联使用。旁路电容器应安装在尽可能靠近电源端子的位置，以获得更佳效果，如以下布局示例所示。

8.4 布局

8.4.1 布局指南

使用多输入和多通道逻辑器件时，输入不得悬空。在许多情况下，未使用数字逻辑器件的功能或部分功能；例如，当仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时。此类未使用的输入引脚不得悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接到由输入电压规范定义的逻辑高电平电压或逻辑低电平电压，以防止其悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常，输入连接到 GND 或 V_{CC}，以对逻辑功能更有意义或更方便者为准。

8.4.2 布局示例

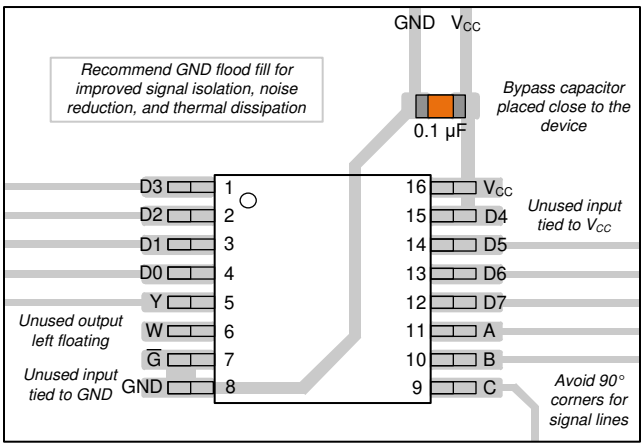


图 8-3. SN74HCS151-Q1 的示例布局。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

9 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

9.1 文档支持

9.1.1 相关文档

如要查看相关文件，请参阅以下内容：

- 德州仪器 (TI)，*HCMOS 设计注意事项* 应用报告
- 德州仪器 (TI)，*CMOS 功耗与 C_{pd} 计算* 应用报告
- 德州仪器 (TI)，*使用逻辑器件进行设计* 应用报告

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击*通知* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的使用条款。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告

静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

TI 术语表	本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision B (December 2021) to Revision C (January 2026)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式	1
• 更新了 V_{T+}、V_{T-} 和 ΔV_T 的最小值和最大值数据	5
• 添加了 V_{T+}、V_{T-} 和 ΔV_T 的典型数据	5
• 新增了输出表注释	11

Changes from Revision A (October 2020) to Revision B (December 2021)	Page
• 向*器件信息* 添加了 WBQB 封装信息	1
• 向*引脚配置和功能*添加了 WBQB 封装	3
• 向“热性能信息”表中添加了 WBQB 封装	4

• 向*特性说明* 部分添加了可润湿侧翼主题 8

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74HCS151QDRQ1	Active	Production	SOIC (D) | 16	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCS151Q
SN74HCS151QDRQ1.A	Active	Production	SOIC (D) | 16	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCS151Q
SN74HCS151QPWRQ1	Active	Production	TSSOP (PW) | 16	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCS151Q
SN74HCS151QPWRQ1.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 16	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCS151Q
SN74HCS151QWBQBRQ1	Active	Production	WQFN (BQB) | 16	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CS151Q
SN74HCS151QWBQBRQ1.A	Active	Production	WQFN (BQB) | 16	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CS151Q

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74HCS151-Q1 :

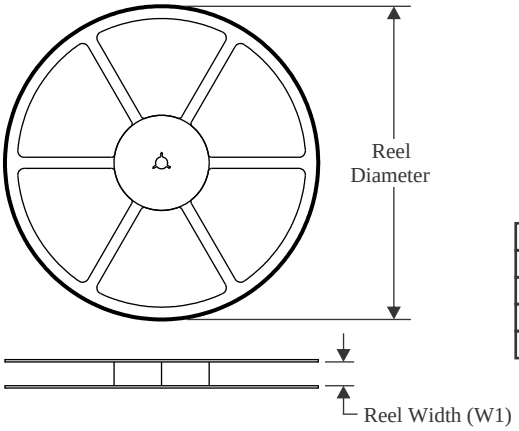
- Catalog : SN74HCS151

NOTE: Qualified Version Definitions:

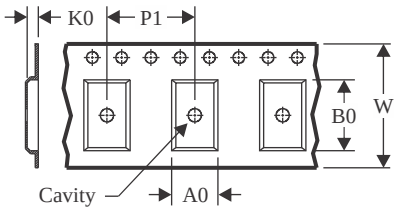
- Catalog - TI's standard catalog product

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

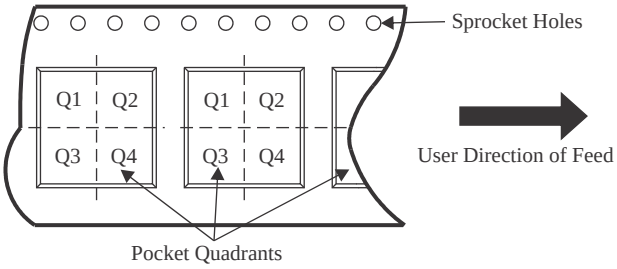


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

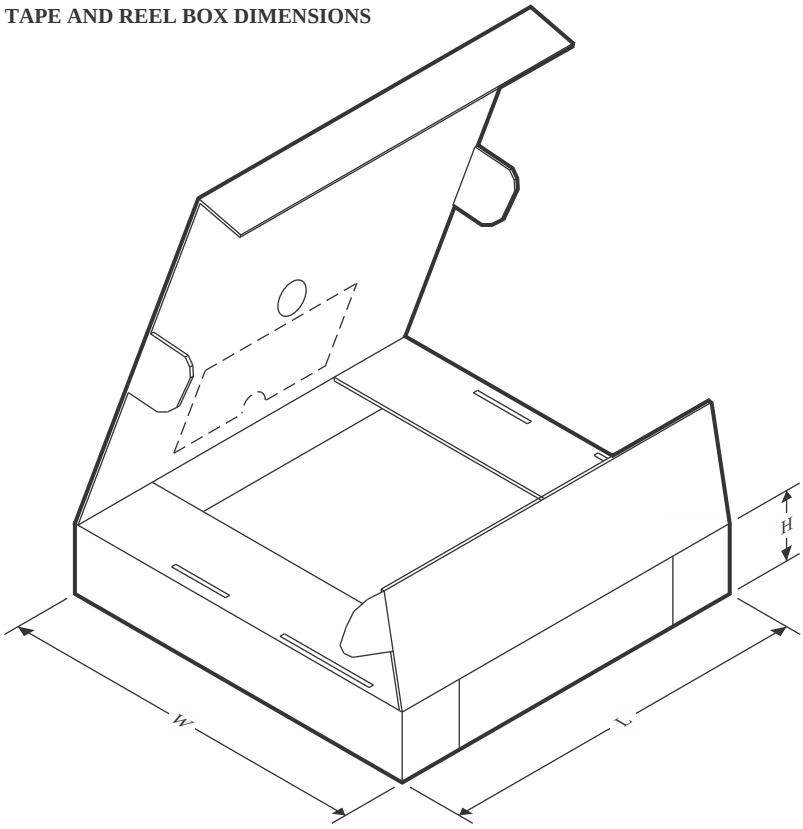
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74HCS151QDRQ1	SOIC	D	16	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74HCS151QPWRQ1	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74HCS151QPWRQ1	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74HCS151QWBQBRQ1	WQFN	BQB	16	3000	180.0	12.4	2.8	3.8	1.2	4.0	12.0	Q1

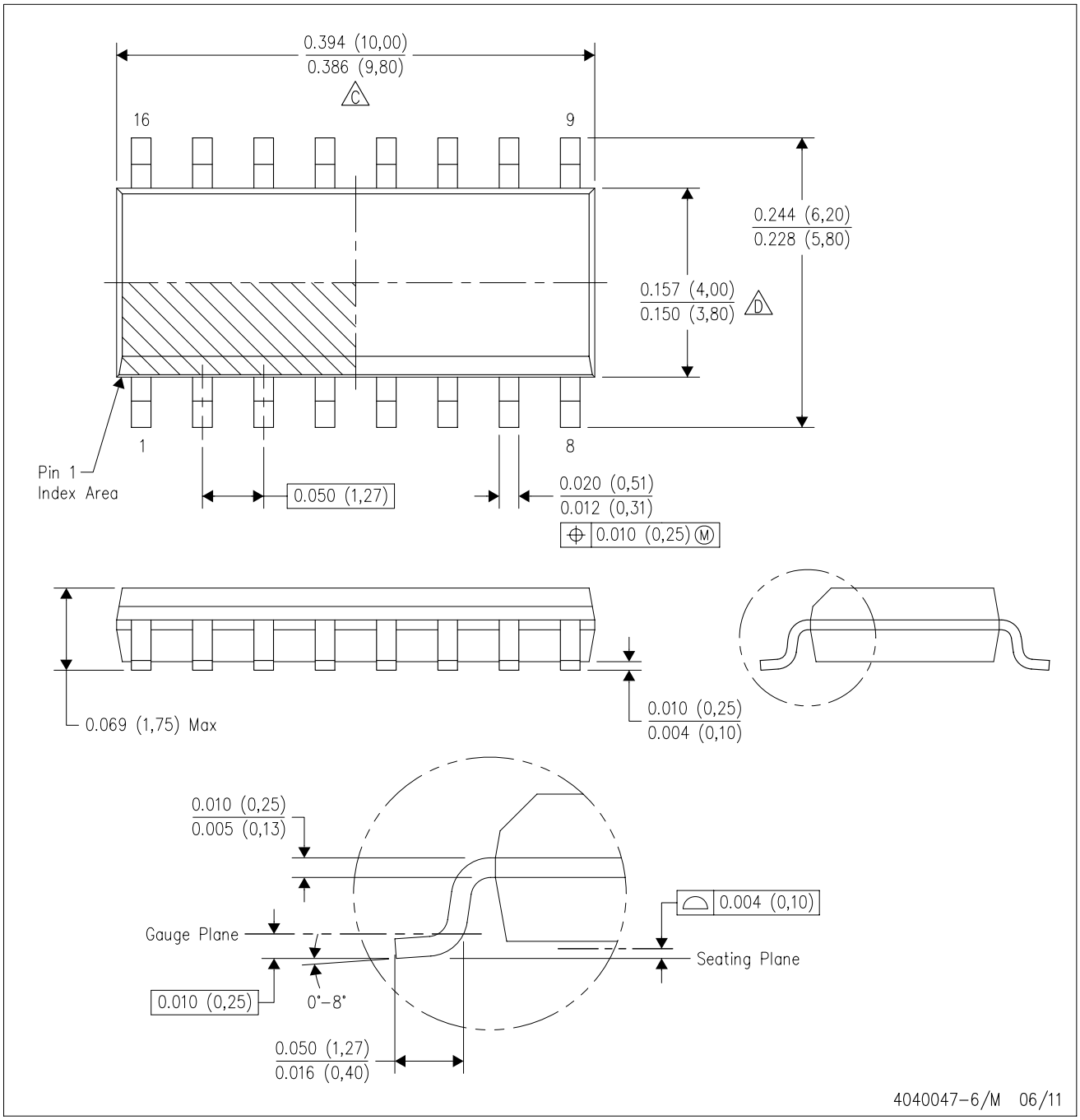
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74HCS151QDRQ1	SOIC	D	16	2500	353.0	353.0	32.0
SN74HCS151QPWRQ1	TSSOP	PW	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74HCS151QPWRQ1	TSSOP	PW	16	2000	353.0	353.0	32.0
SN74HCS151QWBQBRQ1	WQFN	BQB	16	3000	210.0	185.0	35.0

D (R–PDSO–G16) PLASTIC SMALL OUTLINE



NOTES:
A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.006 (0,15) each side.
D. Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.017 (0,43) each side.
E. Reference JEDEC MS–012 variation AC.

GENERIC PACKAGE VIEW

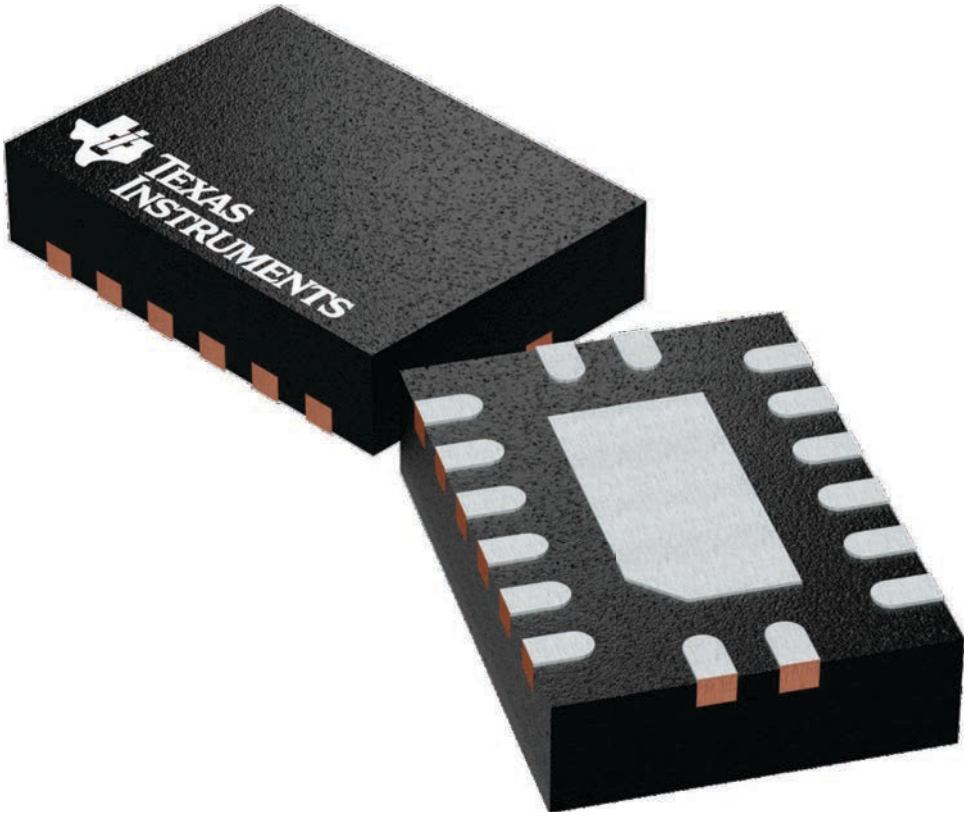
BQB 16

WQFN - 0.8 mm max height

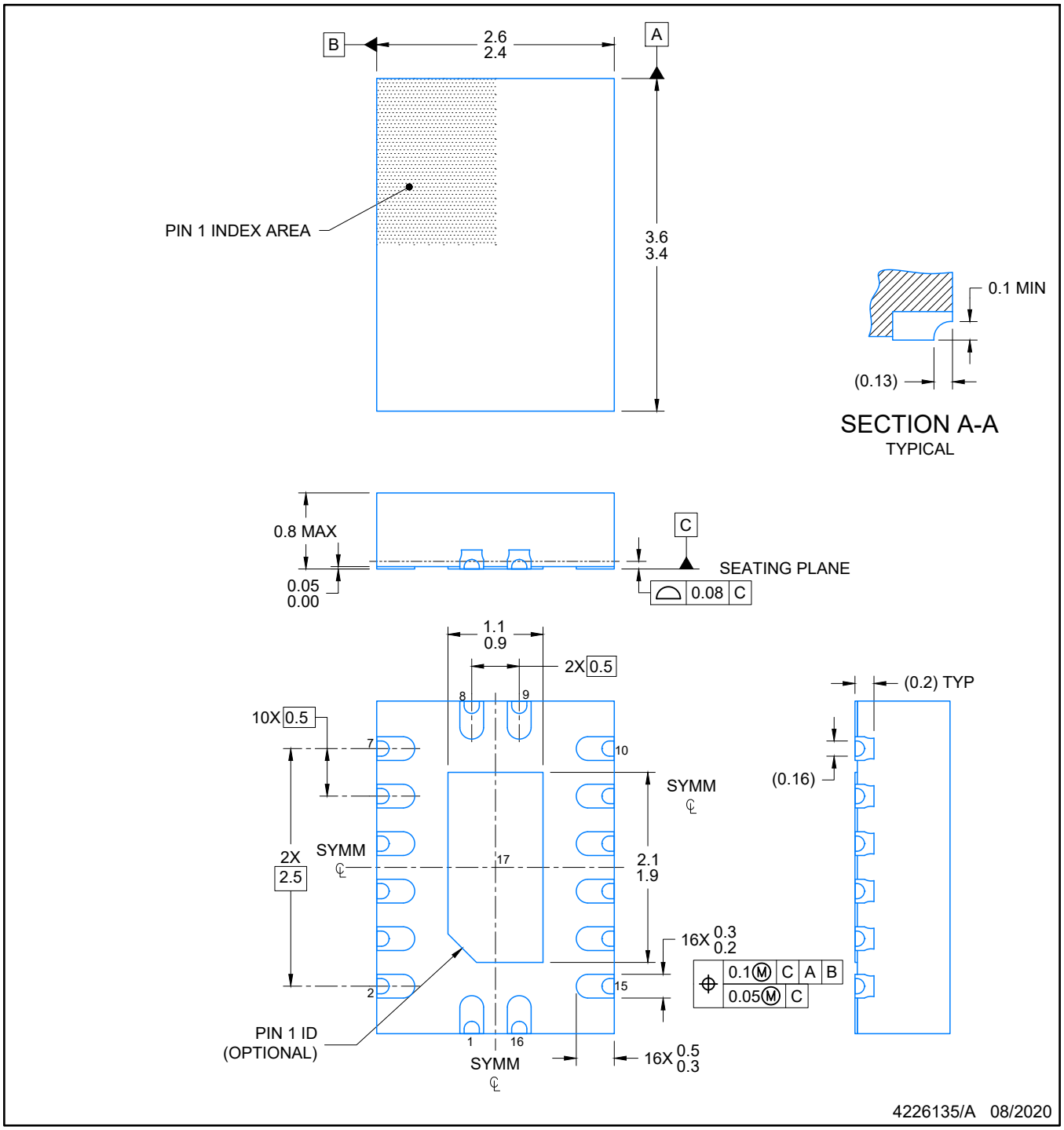
2.5 x 3.5, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

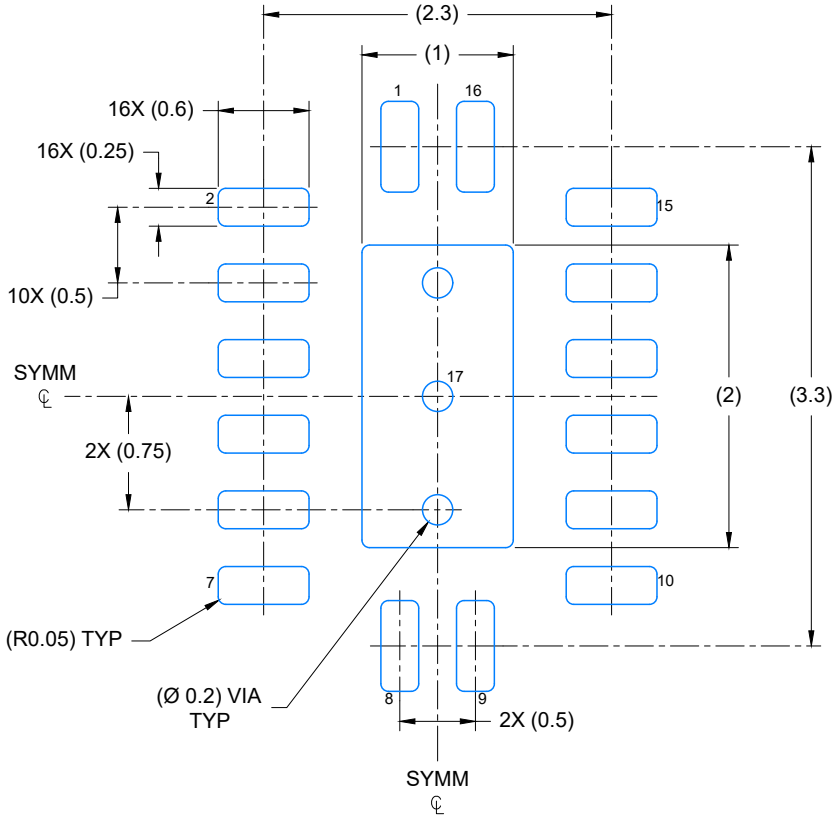


4226161/A



NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.

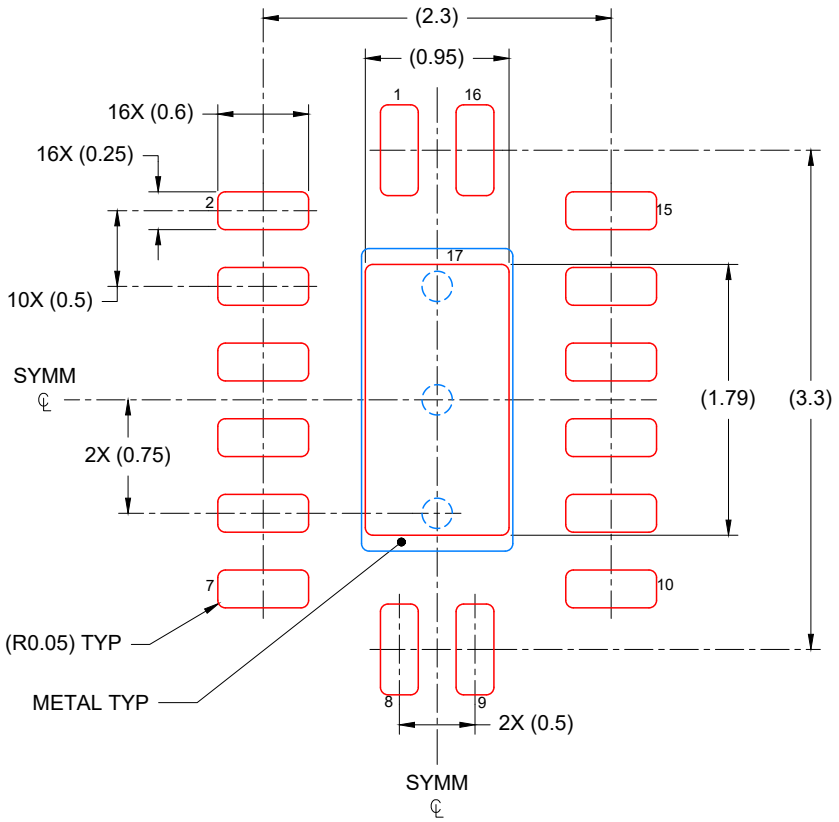


LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X

4226135/A 08/2020

NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



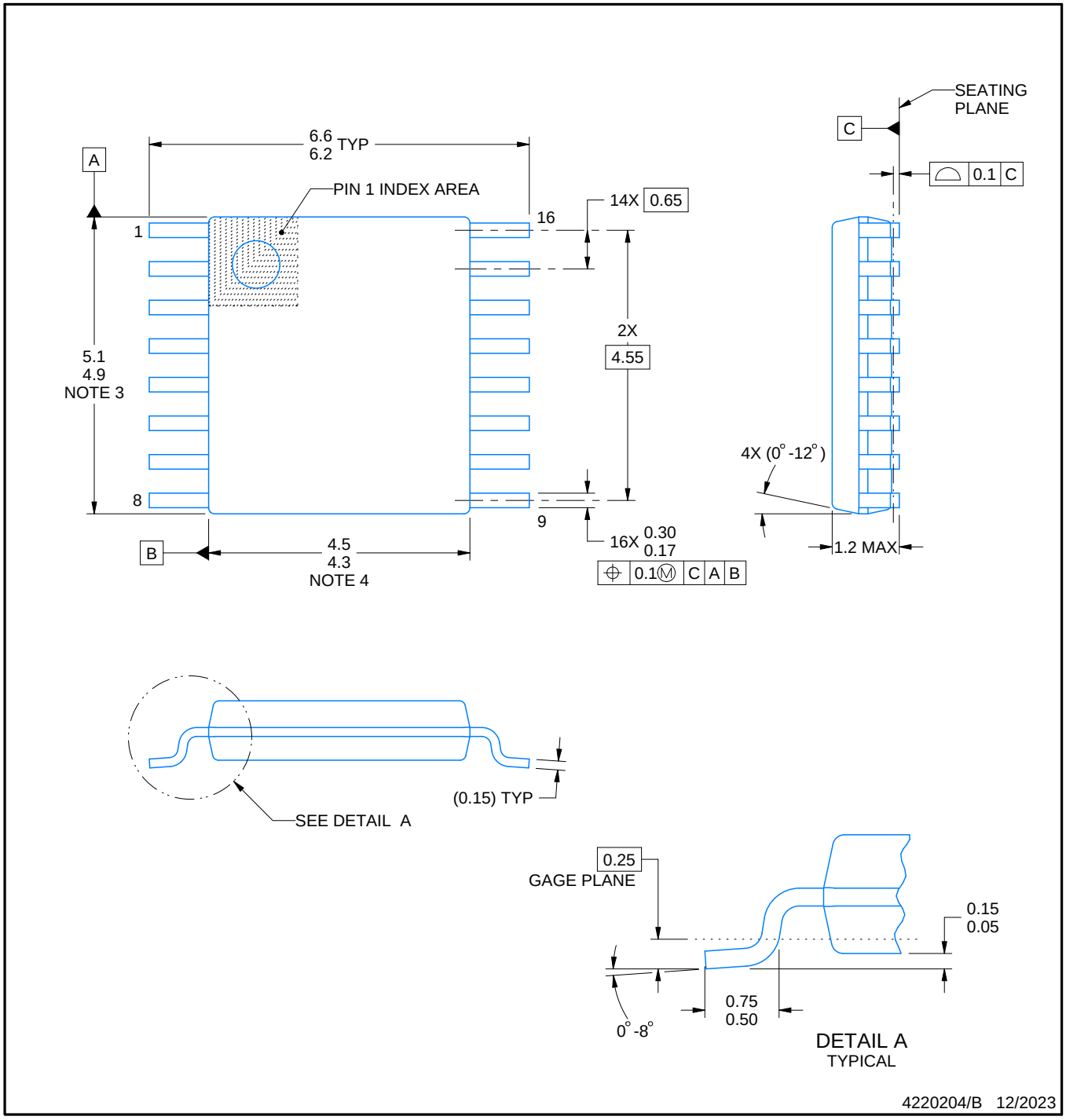
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
85% PRINTED COVERAGE BY AREA
SCALE: 20X

4226135/A 08/2020

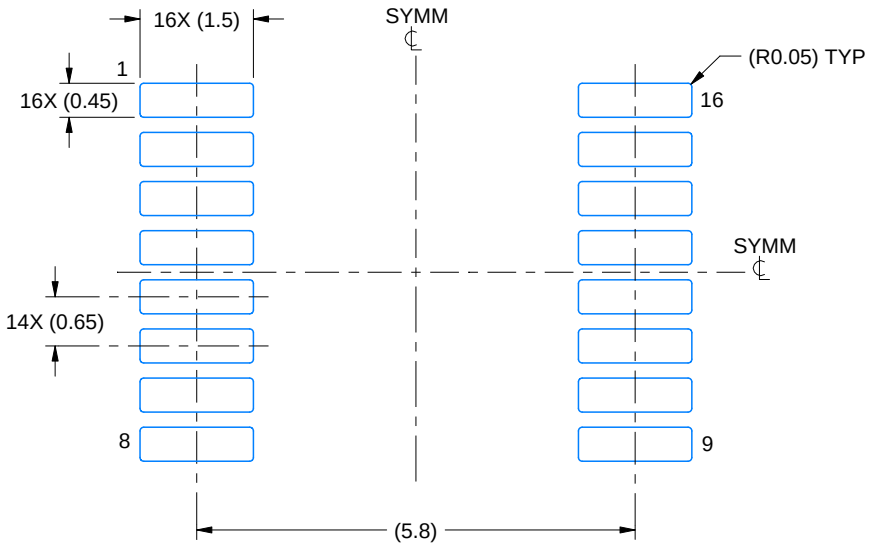
NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.



NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

NON-SOLDER MASK DEFINED (PREFERRED)

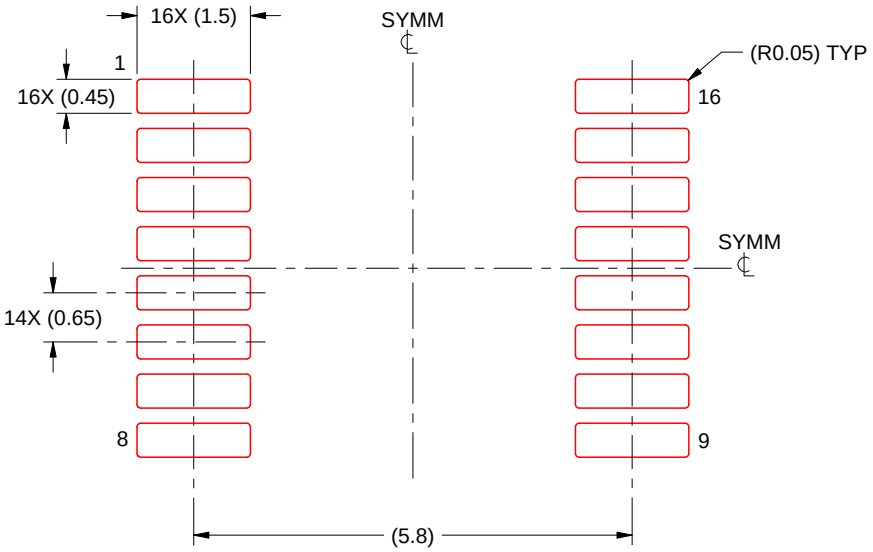
SOLDER MASK DEFINED

SOLDER MASK DETAILS

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月